

SP-31000R



## ・特徴

5 インチから数 mm のチップまで、多様な寸法のスパッタリングが可能です。ターゲットを大きくするとともに、良い膜厚分布を得る事の出来る構造になっています。1 台のスパッタリング用電源で、3 個のターゲットに対して自動切り換え印加が可能で、多層膜生成用に適しています。

## ・仕様

到達圧力	$\times 10^{-5}$ Pa 台※常温・無負荷・脱ガス時
排気速度	$\times 10^{-4}$ Pa 台迄 10 分以内※常温・無負荷・脱ガス時
成膜室径	$\phi 540\text{mm} \times 250\text{mmH}$
スパッタ用電源	RF 電源 13.56MHz 1KW 自動マッチング 1 台
基板形状	5 インチ 1 枚
膜厚分布	$\pm 10\%$ 以内
ターゲット寸法	6 インチ(金属・絶縁物)
ターゲット個数	3
基板回転	無し
基板加熱	常温 $\sim 200^{\circ}\text{C}$ 迄昇温可能
真空排気系	油回転ポンプ : 900L/min メカニカルブースターポンプ : 100m <sup>3</sup> /h クライオポンプ : 1200L/sec
操作方法	自動
ガス系統	マスフローコントローラ 1 系統
ユーティリティ	電気 : AC200V 三相 15KVA 冷却水 : 8L/min 以上 0.1MPa 以上 0.15MPa 以下 25 $^{\circ}\text{C}$ 以下循環 計装エア : 0.5MPa 以上 設置寸法 : 4000mmW $\times$ 2000mmD $\times$ 1800mmH